

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 20 年 1 月 17 日 (2008.1.17)

【公開番号】特開 2002-222831 (P2002-222831A)
【公開日】平成 14 年 8 月 9 日 (2002.8.9)
【出願番号】特願 2001-20002 (P2001-20002)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/60 3 1 1 S

【手続補正書】
【提出日】平成 19 年 11 月 26 日 (2007.11.26)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 0 8
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0 0 0 8】

この半導体チップ 1 表面には、一般にパッシベーション膜が形成されており、また、ボンディングパッド（あるいはランド）2 と呼ばれる表面電極が形成されている。このボンディングパッド 2 は、アルミニウム製ボンディングパッド、金製パンプ等からなるものである。このボンディングパッド 2 は、例えば、半導体チップの表面にアルミニウムを蒸着した後、エッチングすることにより形成することができる。